

北京屹唐半导体科技股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.273 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 670,779,306.87 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,775,299,229.66 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.273 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 2,955,560,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,686,788.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2025 年公司合并报表归属于母公司股东净利润的 12.03%。

2、公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配符合相关法律法规、《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定及公司首发上市承诺的分红规划，未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2025年度
现金分红总额（元）	80,686,788.00
回购注销总额（元）	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	670,779,306.87
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,775,299,229.66
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	80,686,788.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	670,779,306.87
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	80,686,788.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否
现金分红比例（%）	12.03
现金分红比例（E）是否低于30%	是

最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	738,597,459.51
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	5,076,317,948.58
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	14.55
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注1：公司于2025年7月在上海证券交易所科创板上市，公司上市未满三个完整会计年度，仅填报上市后数据。

注2：本表格中的“最近三个会计年度”项下的财务数据仅指2025年度的相关财务数据。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

（一）行业特点及发展情况

受益于人工智能相关应用的爆发式需求带动的高性能计算与数据中心基础设施的持续投资以及汽车电子、工业控制等新兴应用对半导体市场需求的多元化支撑，全球半导体市场规模高速增长，集成电路设备行业作为集成电路产业的基石，正处于市场规模增长与技术迭代加速的关键发展阶段，市场需求持续快速增长。半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，具有较高的技术研发门槛。随着高端逻辑芯片向2纳米及更先进制程迈进、先进存储器芯片3D结构持续演进、先进封装技术等芯片技术的快速迭代，半导体设备面临着更高的技术挑战与技术创新需求，需要半导体设备公司持续进行各项投入。

（二）公司经营模式、盈利水平及资金需求

公司始终坚持致力于通过自主研发创新为集成电路制造环节提供更先进处理能力和更高生产效率的集成电路设备，不断加大研发投入及市场开发力度，持续改进现有干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理设备产品竞争力，并开发推出新产品以进一步扩大公司产品组合，满足国内外客户对高端半导体设备的多

样化需求。2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 670,779,306.87 元，同比增长 24.03%，整体盈利状况较好。公司目前处于快速发展阶段，在研发投入、市场拓展、人才引进、厂房建设、投资并购等方面均需要大量的资金支持。

（三）公司现金分红水平较低的原因

半导体设备行业属于资金密集型行业，具有前期研发及市场开发投入大，实现量产及盈利周期较长的特点。目前公司仍处于快速发展阶段，综合考虑公司的经营计划及资金需求，未来需要充足的资金以保证公司的长远发展，继而更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展。

（四）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司 2025 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以支持公司在研发创新、市场开发、日常运营、人才引进、厂房建设、投资并购等方面的资金投入与长远发展。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供现场投票和网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司高度重视对投资者的长期可持续性回报，后续将严格执行相关法律法规及《公司章程》规定，结合经营实际与发展需要，积极履行公司的利润分配政策和相关承诺，在确保公司高质量发展的同时，稳步提升股东回报水平。

三、公司履行的决策程序

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议，经股东会批准后实施。公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月29日